

日期：106年9月7日
單位：研究發展處

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

計畫業務組 擬辦：

- 一、文陳閱後，公告於電子公佈欄、本組、本處及本校最新消息，並e-mail副知全校教師知照。
- 二、本計畫校內申請截止日為106年11月15日上午10時，欲申請者請於校內截止日前於科技部系統完成線上申請作業，並來電與本組確認，俾利本組於期限前彙送科技部，逾期恕不受理。
- 三、另提醒申請者於提出計畫申請案前，務必更新或確認個人資料（職稱請以人事室核發之正式職稱為準）。
- 四、文存。

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
行政組員 張譯云 09071547		
副教授兼組長 李思禹 09071616		代為決行 教授兼研究發展處長 洪慧芝 09071616

檔 號：

保存年限：

科技部 函

機關地址：台北市和平東路二段106號
聯絡人：潘敏治 副研究員
電話：02-2737-7983
傳真：02-2737-7673
電子信箱：mcpa@most.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國106年9月7日
發文字號：科部工字第1060070326號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本部工程司推動107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」，自即日起接受申請，請查照。

說明：

- 一、本計畫申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提計畫申請書(採線上申請)；申請人之任職機構應於106年11月20日(週一)前備函送達本部(請彙整造冊後專案函送，逾期恕不受理)。
- 二、本計畫規劃將整合學界研發能量與資源，鼓勵學術團隊參與，並與產業共同合作，建立關鍵自主技術及增加附加價值。
- 三、計畫之研究主題必須具有前瞻性、關鍵性及創新性，計畫內容必須陳述國內外現狀及所欲達成之技術指標，同時，必須陳述四年計畫規劃藍圖(roadmap)及執行內容，並具體說明階段性成果與後續產業化成效。
- 四、本部對執行計畫每年進行審查，執行團隊必須定期提報計畫執行進度與成果，並出席各項審查會議，各執行團隊須能展示該計畫所開發之技術或系統成果。
- 五、本計畫徵求公告相關內容業已公佈於本部工程司網站

國立中興大學



(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。

正本：國立臺灣大學等303個機構

副本：本部綜合規劃司、工程技術研究發展司

106/09/07
11:08:35

部長陳良基

裝



訂

線